



Orbotech Nuvogo™ 50F/50FXL

量產細線路直接成像



Orbotech Nuvogo 50F/50FXL

Orbotech Nuvogo 50F/50FXL 是一款量產直接成像解決方案，專為最佳化 HDI，軟板和軟硬結合板應用而設計。Orbotech Nuvogo 50F/50FXL 採用了 KLA 經業界驗證的 LSO™(大鏡面掃描)技術，運用最佳化的光路及先進的漲縮演算法，確保最佳的成像及線路品質。Orbotech Nuvogo 50F/50FXL 系統效率高，連線產能高達每天 7,000 片板子，在保持卓越品質、最高速的同時，降低了總體擁有成本 (TCO)。



優勢

量產數位化成像

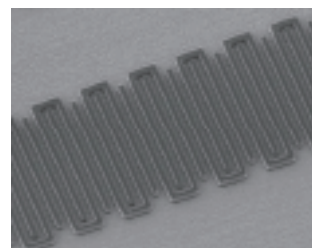
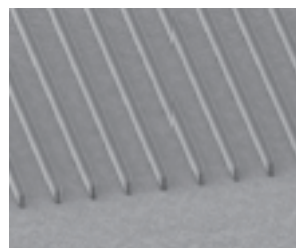
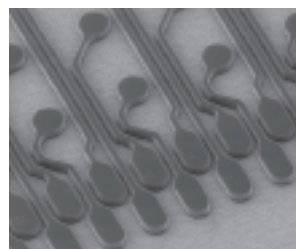
- 高產量: 連線產能高達每天 7,000 片板子
- 高效率的快速靶點捕捉
- 採用雙檯面傳輸機制，最佳化成像時間

高成像品質

- 最優線路結構，低至 15 μm 線寬/間距
- 高景深，能克服具有挑戰性的表面高低變化
- 先進的漲縮模式，可實現出色的對位精度 ($\pm 10 \mu\text{m}$)

高效率

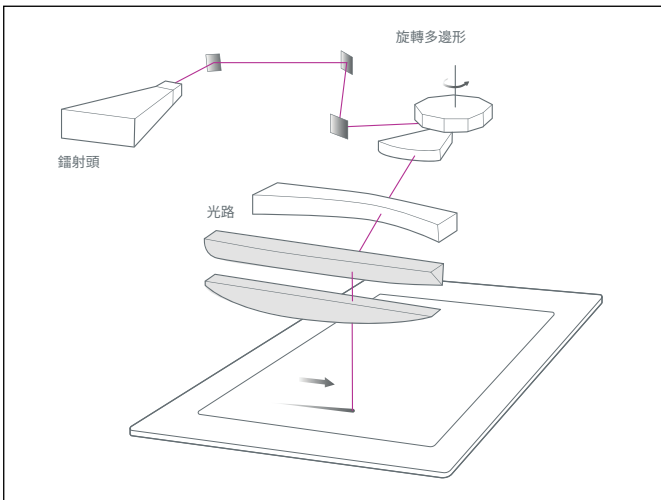
- 高效料號列隊管理，實現最大生產效率
- 配備自動解決方案可實現無縫連接生產
- 高產能帶來更低的每面曝光成本



15/15 μm 的細小線寬/間距

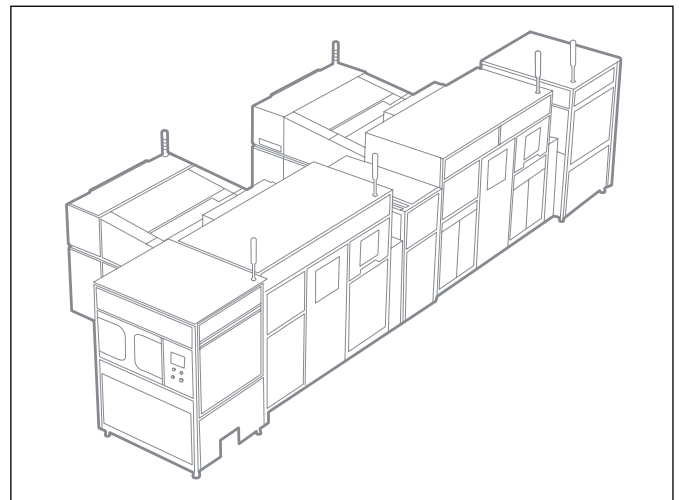


高成像品質

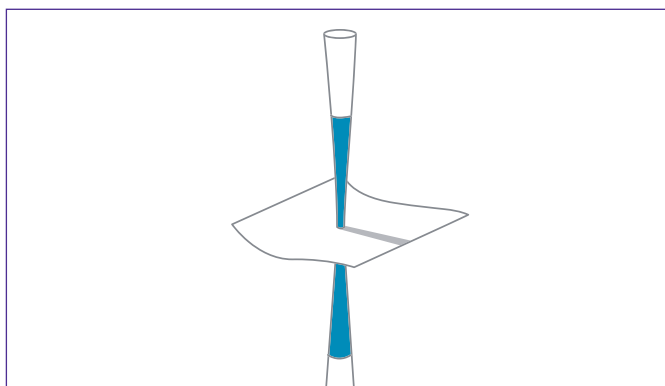


採用 KLA 的 LSO™ (大鏡面掃描) 技術，單次掃描即可實現卓越的線路結構

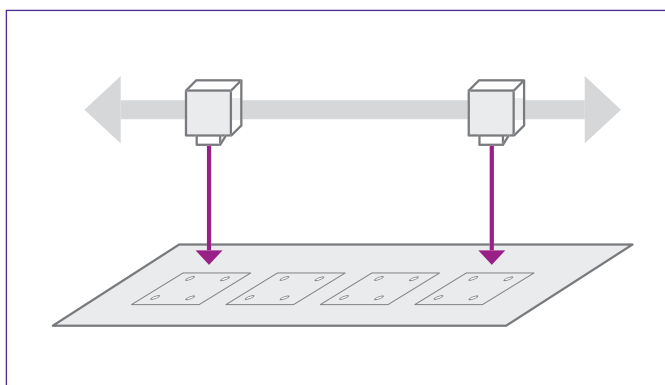
高量產解決方案



配備自動化解決方案



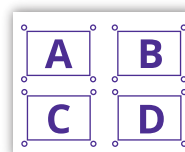
高景深 (DOF) 能克服具有挑戰性的表面高低變化



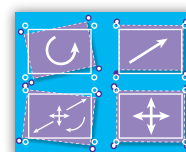
動態靶點識別和捕捉

先進的漲縮模式

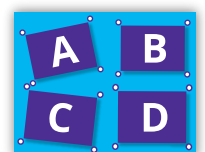
- 智慧漲縮-最佳量產漲縮模式，同批次板件達到最高的一致性
- 自動漲縮/固定漲縮/群組漲縮
- 分割漲縮—超薄內層分區對位
- 極速靶點捕捉，降低產能損失



CAM 數據



板子



圖像

可追溯性

Orbotech Nuvogo 支援通過動態標記進行板子追蹤，包括：序號標識，小排版和 PCB ID，日期與時間標識，漲縮標識和設備 ID。

規格

	Orbotech Nuvogo 50F	Orbotech Nuvogo 50FXL
最大產能*	每小時 300 面 成像尺寸 24" x 18"	每小時 290 面 成像尺寸 25" x 18"
最小線寬/間距*	15/15μm	
解析度	1.5μm	
對位精度 FtG**	±10μm	
層間對位精度 FtB**	20μm	
最大基板尺寸	635mm x 660mm 25" x 26"	660mm x 812mm 26" x 32"
最大曝光尺寸	609.6mm x 660mm 24" x 26"	635mm x 812mm 25" x 32"
基板厚度	0.025mm - 8mm	
成像能量範圍	10 - 2,200mj/cm ²	

* 取決於感光膜特性，能量值，靶點捕捉和漲縮演算法

** 所有值均為 3σ 四個目標定位

以上產品規格如有變更恕不另行通知

KLA 支持

KLA Services 是全球客戶值得信賴的合作夥伴，從設備安裝和系統最佳化到生產力提升和全球供應鏈管理，專注於不斷提升設備性能和可用性，提供絕佳客戶體驗。

KLA Corporation

www.kla.com

Rev 4.1_08-31-2023